后。但华虹宏力与客户携手成功开发了基于沟槽栅结构的600V-1200V 场截止型 IGBT，打破了国外公司的技术垄断，填补了国内空白。截至目前，华虹宏力独特且具竞争力的场截止型 IGBT 累计出货量已超过 30,000 片晶圆，并保持快速增长趋势。

华虹宏力设计经理杨光军也在会议上发表了题为“嵌入式存储器（eNVM）助力物联网发展”的精彩演讲。他表示，物联网产业发展迅猛，半导体行业也顺势而上。华虹宏力拥有全球领先的嵌入式存储器工艺平台组合，技术节点涵盖 0.5 微米至 90 纳米。2016 年，华虹宏力 90 纳米 eNVM 工艺成功量产，采用公司 eNVM 技术制造的金融 IC 卡芯片产品分别成功获得国际权威机构颁布的 CC EAL5+、EMVCo 安全证书，以及万事达 CQM 认证。而应对微控制器（MCU）应用，华虹宏力推出了 0.11 微米超低漏电（ULL）嵌入式闪存及 eEEPROM 技术平台，可提供全面、灵活、极具竞争力的解决方案，在物联网、可穿戴设备、智能电网及汽车电子设备等领域有着广泛应用。华虹宏力将牢牢把握物联网市场机遇，持续提升工艺性能，坚持创新，不断追寻“芯”梦想。CRC

格罗方德在成都建立 12 英寸晶圆生产基地 投资超百亿美元

新年春节过后不久从成都传来重磅消息，全球第二大晶圆代工厂格罗方德半导体股份有限公司（GlobalFoundries）在此宣布，正式启动建设 12 英寸晶圆成都制造基地，推动实施成都集成电路生态圈行动计划，投资规模累计超过 100 亿美元。

格罗方德是全球领先的集成电路企业，致力于为全球最出色的科技公司提供独一无二的设计、开发和制造服务。

当天，格罗方德 12 英寸晶圆成都制造基地项目在成都高新区正式签约并举行开工仪式。

投资逾百亿美元，成都迎来首条 12 英寸晶圆生产线

此次落户成都高新区的 12 英寸晶圆生产基地，一期建设主流 CMOS 工艺 12 英寸晶圆生产线，预计 2018 年底投产；二期建设格罗方德最新的 22FDX® 22nm FD-SOI 工艺 12 英寸晶圆生产线，预计 2019 年第四季度投产。

此外，成都市和格罗方德还将共同推动实施“成都集成电路生态圈行动计划”，在多个领域开展深度合作，从而在整体上形成逾 100 亿美元的投资规模。

“今天，我们与合作伙伴携手共进迈出勇敢的一步，在此举行奠基仪式。这里将会落成中国最大和最先进的 12 英寸晶圆厂。”格罗方德首席执行官桑杰　贾在开工仪式上表示，“得益于成熟的基础设施，熟练的劳动力，以及众多领先技术公司的驻扎，成都市毫无疑问是这个倡议的优秀合作伙伴。随着规模最大的 12 英寸晶圆厂落户中国，此次合资企业的成立将极大提高成都市作为国家半导体和 IT 产业领导者的美誉，进一步吸引更多科技企业投资落户，最终使成都成为国际卓越的 FD-SOI 产业中心。”

成都高新区相关负责人表示，格罗方德成都项目的开工契合《国家集成电路产业发展推进纲要》，填补了中国西南地区 12 英寸先进工艺晶圆生产项目的空白，将进一步壮大成都电子信息产业规模，有效提升成都集成电路产业发展生态，助推成都市打造全球知名集成电路产业基地，推动成都国家中心城市建设。

截至 2015 年底，12 英寸晶圆占据全球晶圆产能的 63.1%，预测到 2020 年该比例将增加至 68%，因此，全球晶圆产能到 2020 年都将延续以 12 英寸晶圆“称霸”的态势。

成都制造基地项目将会投产格罗方德最先进技术的其中之一。其 22FDX® 22nm FD-SOI 生产工艺具有功耗省、综合成本低等优势，可广泛应用于各类移动终端、物联网、智能设备、汽车电子、5G 无线基础设施等领域，在全球拥有巨大的市场需求。

随着新合资公司的成立，格罗方德亦将在中国市场公布其全新的中文名称：“格芯”。首字为“格”，和公司现有中文名称的第一个字相同，亦有“探究事物原理，而从中获得智慧”的含义。次字是“芯”，表达“芯片”之意。两个字合在一起发音与“革新”相同，寓意着重生、振兴与改革。“格芯”不仅将极大改变晶圆代工行业的格局，更会为中国半导体产业带来全新视角。CRC